

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中信证券、申万宏源证券、西南证券、银叶投资、华金证券、金鼎资本、东北证券自营、宏利基金
时间	2024年1月10日-2024年1月11日
地点	公司会议室及线上
上市公司接待人员姓名	常务副总经理、董事会秘书、财务总监：陈小华 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</b></p> <p><b>问题一：在先进封装与传统封装领域，公司产品要求有什么差异？</b></p> <p>回答：以电镀液产品为例：</p> <p>在传统封装领域，主要产品配方为电镀锡，以表面活性剂为主。需要适应多种封装形式（QFN、DFN、SOP等）和基材（铜、镍、铁镍合金等），适应较宽的工艺窗口，电镀电流密度范围达到0.5ASD-60ASD，适应不同电镀形式，包括连续电镀、滚镀和挂镀等；</p> <p>在先进封装领域，主要产品配方为电镀铜，以光亮剂、整平剂、载运剂为主，需要同时满足于Bumping（凸块）、RDL（线路重排层）的电</p>

	<p>镀，电镀的均匀性要求高，差异小于 10%，纯度要求高，金属杂质和颗粒物含量控制达到 ppm 以上级别。</p> <p><b>问题二：g/i 线光刻胶、OLED 光刻胶、PSPI 光刻胶的技术难度？</b></p> <p>回答：在先进封装、OLED 显示面板领域，g/i 线光刻胶的分辨率能够满足目前加工工艺的需求，且该领域特有的功能要求带来差异化的技术要求和难点，并非单独依靠更高分辨率的光刻胶就能解决。</p> <p>比如，先进封装领域用通过光刻工艺制作铜凸块和 RDL 线路，其中单个凸块高度达到 50~100<math>\mu\text{m}</math>，是一般集成电路电路厚度的 50~100 倍。因此，相较于晶圆制造所用光刻胶，先进封装中的光刻胶要求更大的涂布厚度、更高的宽深比、更高的显影后垂直度，且需要耐受电镀工艺不变形。</p> <p>OLED 阵列制造用光刻胶与晶圆制造 i 线光刻胶一样需要满足 1.5<math>\mu\text{m}</math> 的分辨率。其特殊要求主要体现在大尺寸涂布均匀性、多种底材适应性和低感度等。OLED 阵列制造用光刻胶主要用于在大面积的玻璃基板上完成像素阵列的制造，其涂布面积远大于集成电路的晶圆，是 12 寸晶圆的 32 倍大小。在大尺寸涂布的情况下，OLED 阵列制造用光刻胶的均匀性差异要求低于 3%，要求高于一般晶圆制造中 5% 以下的差异要求。此外，OLED 阵列制造过程使用一款光刻胶完成多层结构制造，因此需要光刻胶对玻璃、钛、ITO、PI 等多种底材具有良好的结合力。</p> <p>此外，同样采用 g/i 线曝光光源的 PSPI（光敏聚酰亚胺）主要用于部分芯片结构的绝缘层，作为直接材料保留在器件里，对可靠性要求更高，技术难度甚至高于光刻胶。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 1 月 12 日